



8430

产品信息



45µm琥珀热反应性HAF胶带

产品描述

tesa® HAF 8430 是一款基于活性酚醛树脂与腈橡胶的热反应型双面棕色胶带。

胶带特性：

- *可靠的芯片粘接
- *适用于PVC,ABS,PET,PLA及PC卡
- *在所有常见注入线上都具有良好的操作性
- *优秀的抗老化性
- *高橡胶含量具有永久的柔韧性

特点

- Reliable chip module bonding
- Suitable for PVC, ABS, PET, and PC cards
- Good workability on all common implanting lines
- Outstanding ageing resistance
- Lifelong flexibility due to high rubber content
- At room temperature tesa HAF® 8430 is not tacky.

应用

tesa® HAF 8430 用于芯片模块嵌入到智能卡中。

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	无	• 总厚度	45 µm
• 胶粘剂类型	丁腈橡胶/酚醛树脂	• 颜色	琥珀色
• 离型纸类型	玻璃纤维纸		

属性/性能值

- 粘接强度 (动态剪切力) 12 N/mm²

附加信息

智能卡应用的技术参数推荐：

tesa® HAF 8430不是自粘胶带，需要施以一定级别的热量和压力使其产生粘性。

以下是所推荐的机器运行的参数。请注意，最佳工艺参数强烈取决于机器的类型，特别是卡身和芯片模块的材料以及客户的要求。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=08430>



8430

产品信息

附加信息

1. 预贴：

在预贴过程中，胶带贴在模块带上。这个步骤可以在线或者离线进行。预贴过程不会影响胶带的存放寿命。预贴模块带可以保存和胶带一样的时间。

机器设定：

- 温度 120 – 140 °C
- 压力 2 – 3 bar
- 时间 2.5 m/min

2. 模块嵌入：

在模块嵌入过程中，预贴模块是模块带上模切件定位到卡腔内，然后加热永久固定到卡身里。这个步骤确切的操作取决于注入线的类型。现在，有两种最常用的方式：

单步操作-机器设定

- *温度¹ 180 - 200 °C
- *压力 65 - 75 N/module
- *时间 1.5 s

多步骤操作（2次或以上加热贴合）-机器设定：

- 温度¹ 180 – 200 °C
- 压力 65 - 75 N/module
- 时间 2 x 0.7 s / 3 x 0.5 s

¹ 温度为在热压头内侧所测量而得。针对不同卡片材料，推荐使用不同温度：

- PVC与ABS: 180 – 190 °C
- PET与PC: 190 – 200 °C

注：粘贴强度数值是在标准实验室条件下获得的。针对每一批次产品，这一数值都需通过规格极限检查（材料：铝蚀刻测试样本；粘接条件：温度=120°C；压力=10 bar；时间=8分钟）

为获得最大粘接力，被粘材料表面需保持洁净、干燥。存储条件参考tesa® HAF存放条件。



8430

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=08430>